

課題番号 : F-18-NU-0101
利用形態 : 技術相談
利用課題名(日本語) : 銅配線メッキ膜の解析
Program Title (English) : Analysis of the copper wiring plating film
利用者名(日本語) : 北島瑞希
Username (English) : M. Kitajima
所属名(日本語) : フジデノロ株式会社
Affiliation (English) : Fujidenolo CO. LTD.
キーワード/Keyword : 分析、形状・形態観察、ナノエレクトロニクス

1. 概要(Summary)

メッキ銅配線を使用したセンサの高分解能化の研究におけるメッキ内構造の解析について、名古屋大学大学院工学研究科 電子工学専攻の加藤剛志准教授に技術相談を行った。

その結果、高分解能化についての最適なメッキ内構造と透過型電子顕微鏡を使用した観察時の試料加工方法についてアドバイスを受け、構造解析の計画を立案した。

2. 実験(Experimental)

< 技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。 >

3. 結果と考察(Results and Discussion)

< 技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。 >

4. その他・特記事項(Others)

なし。

5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)

なし。

6. 関連特許(Patent)

なし。